

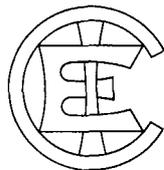
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
IEC STANDARD

**Modification**

**Amendment**

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 60372:1985 AM1:1985  
**Withdrawn**



Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe  
Genève, Suisse

n° 1  
Août 1985  
à la

No. 1  
August 1985  
to

Publication 317-2  
1970

---

Spécifications pour types particuliers  
de fils de bobinage

Deuxième partie:  
Fils de section circulaire en cuivre émaillé soudable,  
adhérent sous l'action de la chaleur ou de solvant

---

Specifications for particular types  
of winding wires

Part 2:  
Heat or solvent bonding self-fluxing enamelled round copper wires

---

Les modifications contenues dans le présent document ont été approuvées suivant la Règle des Six Mois.

Les projets de modifications, discutés par le Comité d'Etudes n° 55, furent diffusés en janvier 1984 pour approbation suivant la Règle des Six Mois, sous forme de document 55(Bureau Central)271.

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote, document 55(Bureau Central)281.

The amendments contained in this document have been approved under the Six Months' Rule.

The draft amendments, discussed by Technical Committee No. 55, were circulated for approval under the Six Months' Rule in January 1984, as Document 55(Central Office)271.

Further details can be found in the Report on Voting, Document 55(Central Office)281.

© CEI 1985

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Page 16

Remplacer l'article 17 existant par le suivant:

17. *Essai de brasabilité*

17.1 *Diamètre nominal du conducteur jusqu'à et y compris 0,1 mm*

La température du bain de soudure doit être de  $375 \pm 5$  °C. Le temps d'immersion doit être de 2 s.

La surface du fil étamé doit être lisse, sans trous ni résidus d'émail.

17.2 *Diamètre nominal du conducteur supérieur à 0,1 mm*

La température du bain de soudure doit être de  $375 \pm 5$  °C. Le temps d'immersion (en secondes) doit être le multiple ci-dessous du diamètre nominal du conducteur (en millimètres) avec un minimum de 3 s.

Grade 1	Grade 2
15 ×	20 ×

La surface du fil étamé doit être lisse sans trous ni résidus d'émail.

Page 17

Replace the existing Clause 17 by the following:

17. *Solder test*

17.1 *Nominal conductor diameter up to and including 0.1 mm*

The temperature of the solder bath shall be  $375 \pm 5$  °C. The immersion time shall be 2 s.

The surface of the tinned wire shall be smooth and free from holes and enamel residues.

17.2 *Nominal conductor diameter over 0.1 mm*

The temperature of the solder bath is  $375 \pm 5$  °C. The immersion time (in seconds) shall be the following multiple of the nominal conductor diameter (in millimetres) with a minimum of 3 s.

Grade 1	Grade 2
15 ×	20 ×

The surface of the tinned wire shall be smooth and free from holes and enamel residues.